

光力科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

报告期内，新冠病毒的影响叠加复杂多变的国际形势，使全人类面临着生存危机和巨大经济下行的挑战。面对复杂多变的国际和国内形势，公司克服重重困难，着力加快半导体封测装备领域新兴业务的整合和发展，对在海外并购的英国两个全资子公司和参股的以色列 ADT 公司的业务、研发、生产、供应链进行融合和整合，效果已逐步呈现，进一步提高了公司核心竞争力和抗风险能力；公司原有业务，通过经营管理层和全体员工的艰苦努力，业绩稳定增长，发展态势良好，继续保持了优于同行可比上市公司的指标，在全球疫情持续蔓延的不利环境下取得如此成绩是非常不易的。

上市 5 年来，公司全力布局和发展的半导体封测装备新兴业务，报告期内在并购整合、产品研发、国产化进程等方面均取得优异成绩：

报告期内，收购完成 LP、LPB 剩余 30%股权，使 LP、LPB 成为公司全资子公司，并于 2020 年 11 月底完成这两个公司的合并，进一步提升运营管理效率。通过收购英国 LP 和 LPB 全部股权，使公司 100%拥有技术壁垒极高的高性能、高精度空气主轴技术和生产工艺制造方法，保障了公司在半导体切割划片机生产过程核心零部件的供应。同时，高性能、高精度空气主轴是工业精密装备的核心“关节”，一直以来都是高精密装备“卡脖子”的核心零部件，有非常广泛的行业应用和产品应用。例如，当下英国公司生产的空气主轴不但使用在半导体划片机上，还给研磨机和抛光机供应适合的空气主轴，此外，还供货空气主轴用于汽车自动

喷漆、光学镜片磨削高精密装备等等。未来公司将依托空气主轴延展更广阔的新的行业应用和产品应用。

报告期内，公司对 ADT、LP/LPB 在业务、研发、生产、供应链、产品等方面整合和深度合作，提升了公司在该领域的整体竞争力。充分发挥中国本土化优势，快速推进了半导体后道封测装备国产化的进程。组建的中国区销售和服务团队，全力推广适合下游客户封测需求的切割划片机；构建的全球供应链中心正在快速推进中，为批量化生产提供了保障。

2020 年 6 月，由郑州研发团队携 ADT、LP/LPB 研发团队的工程师合力研制的 8230 型号全自动双轴晶圆切割划片机成功亮相 SEMICON China 2020 国际半导体展会，10 月新产品发布会后，产品陆续进入国内外头部封装厂进行晶圆切割产品验证，效果显著。2021 年，8230 机器正式进入量产和订单阶段。此外，在与 8230 共用的技术平台之上，郑州研发团队快速研制出适合第三代半导体应用材料切割的 6110 型号新产品，于 2021 年 3 月亮相 SEMICON China 2021 国际半导体展会，并于展会后快速推向市场。

公司在半导体新产品研发及国产化落地方面能够快速推进、取得好的成效，得益于传统业务安全生产监控装备常年累积的软硬件技术平台和管理平台发挥的优势，并将其完美融入到半导体新兴业务产品的研发和制造中。

传统安全生产监控装备业务，报告期内，取得了稳定的业绩增长：（1）近年来持续广泛和深入开展的降本增效工作呈现良好效果，产品成本有较大幅度降低，公司盈利能力持续提高。（2）紧抓国家新的瓦斯防突细则出台带来的市场机会，发挥核心产品市场优势，促进客户升级改造建立技术平台，推广透地通信人员定位系统和采空区火源定位系统，加大市场开拓力度，深挖市场需求，继续保持了行业的领先地位。（3）电力安全和节能环保业务，氨逃逸、喷氨优化、NOx 在线监测、飞灰含碳等新产品的市场销售和发展取得重要成效。

报告期内，公司航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期工程建设于 2020 年 9 月正式开工，预计 2021 年 10 月主体工程完工。公司将确保半导体封测装备生产车间早日投入使用，实现半导体封测装备国产化批量化生产供货，夯实公司发展基础，促进公司长远发展。

2020 年公司积极化解疫情影响，即使在大环境不利的情况下，公司经营业绩仍保持稳定的增长态势：公司 2020 年实现营业收入 31,130.44 万元，同比上升 4.94%；归属于上市公司股东的净利润为 5,935.17 万元，同比增长 5.76%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年度，公司共召开了九次董事会会议，具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2020 年 3 月 27 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于公司其他高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于业绩承诺完成情况的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
2	2020 年 4 月 17 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	2020 年 4 月 28 日	第四届董事会第二次会议	《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》
4	2020 年 6 月 18 日	第四届董事会第三次会议	关于收购控股子公司 Loadpoint Limited 及 Loadpoint Bearings Limited 剩余少数股权并增资 Loadpoint Bearings Limited 的议案

5	2020 年 7 月 29 日	第四届董事会 第四次会议	《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 《关于〈公司 2020 年总经理半年度工作报告〉的议案》 《关于向广发银行郑州分行申请敞口授信额度的议案》
6	2020 年 9 月 11 日	第四届董事会 第五次会议	《关于聘请 2020 年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构的议案》 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	2020 年 9 月 14 日	第四届董事会 第六次会议	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式及发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、定价方式和发行价格 (5) 发行数量 (6) 限售期 (7) 募集资金金额及用途 (8) 上市公司滚存未分配利润的安排 (9) 上市地点 (10) 决议有效期 《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》 《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》 《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 《关于设立募集资金专项账户的议案》 《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
8	2020 年 10 月 28 日	第四届董事会 第七次会议	《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》
9	2020 年 12 月 1 日	第四届董事会 第八次会议	《关于部分募投项目延期的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2020 年 4 月 17 日	2019 年年度股东大会	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》 选举公司第四届董事会非独立董事 选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事 选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董事 选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事 选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事 选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事 选举公司第四届董事会独立董事 选举王红为公司第四届董事会独立董事 选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事 选举江泳为公司第四届董事会独立董事 选举王林为公司第四届董事会独立董事 10、《关于公司监事会换届选举的议案》 选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事 选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事 11、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 12、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
2	2020 年 9 月 30 日	2020 年第一次临时股东大会	1、审议《关于聘请 2020 年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构的议案》 2、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 3、审议《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》 3.1 发行股票的种类和面值 3.2 发行方式及发行时间 3.3 发行对象及认购方式 3.4 定价基准日、定价方式和发行价格 3.5 发行数量 3.6 限售期 3.7 募集资金金额及用途

			3.8 上市公司滚存未分配利润的安排 3.9 上市地点 3.10 决议有效期 4、审议《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》 5、审议《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》 6、审议《关于〈公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 7、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 8、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 9、审议《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
--	--	--	--

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 5 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标

准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案及公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2021 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

（四）独立董事履行职责情况

在 2020 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。2020 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、2021 年度公司的经营计划

2021 年，中国企业可能面临西方国家更加严厉的技术封锁和贸易制裁，特别是在高科技领域，尤其针对半导体芯片制造相关环节，是挑战，也是机遇。无论外界环境如何变化，公司将立足实业，沿着已经布局的清晰的发展战略，持续加大研发投入和市场投入，迅速做强做大半导体业务。

公司将植根中国，致力于成为掌握核心技术的全球一流半导体装备企业：

聚焦半导体装备领域，对标行业世界领军企业，深耕空气主轴以及衍生产品空气导轨在半导体领域的应用，结合原有业务技术优势率先切入半导体切割划片机，纵向布局最主流最先进切割划片机产品，横向布局其他高端超精密半导体装备。

未来公司将依托积累的技术优势和产业优势，延展高性能高精度空气主轴等核心零部件到更多的产品应用领域，实现更大的发展。

2021 年，经营管理层将在董事会的领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的战略布局、年度经营目标和工作计划，扎实推进各项工作的开展。

2021 年具体经营计划如下：

1) 市场营销工作

半导体业务板块，12 寸全自动切割划片机 8230 在 2020 年第四季度逐步进入 DEMO 阶段，2021 年陆续实现销售供货。半导体封装测试厂家依据严格的 SEMI 国际标准规范，新产品导入必须遵循苛刻的长达半年或以上试切和验证阶段。各个半导体封装测试厂因切割产品的不同、工艺要求的不同，所以前期验证的周期比较漫长，需要营销和服务体系全力配合研发和现场应用工程师尽快通过划片机在客户处的试切和验证工作，尽早进入批量采购合格供应商清单，完成 2021 年销售目标。此外，在划片机主机推广和销售同时，做好辅机和耗材的销售和服务工作。

2021 年 SEMICON China 国际半导体展会于 3 月 17-19 日召开。充分利用半导体展会的窗口，一方面加大 8230 机型的销售推广，另一方面，面向第三代半导体材料切割的新机型 6110 也首次亮相 SEMICON China 展会，做好新产品推介和宣传工作。

随着划片机的 DEMO 和销售，在全国范围内扩大技术服务网点的部署。同时，在下半年疫情允许情况下，将 8230 机型发往台湾地区进行 DEMO 和销售推广。

2021 年安全监控装备业务，结合国家新的产业政策、法规，持续发挥核心产品在市场上的竞争力，加大透地通信人员定位系统、采空区火源定位系统和随钻轨迹实时监控系统的推广。同时，顺应市场新的变化，联合行业专家，主办、协办大型会议，积极探索新的营销模式，推动安全监控装备业务快速增长。加快货款回笼，严格筛选招投标项目，严格控制新增订单可能

带来的坏账风险，全力清除陈年旧账。

2021 年国际煤矿装备展会将于 10 月在北京召开，充分利用公司在行业的地位和口碑，携优势产品和新产品亮相展会，加大宣传和展示力度，进一步提升和扩大市场影响力，推动业绩高质量的增长。

2) 产品研发工作

公司的各研发项目组是 2020 年整个公司最忙碌的部门，疫情期间更是如此。正是研发团队日以继夜的努力，多款新产品才能在如此短的时间内研制成功并推向市场。2021 年研发团队工作更加繁忙，特别是半导体项目组，由于 8230 已进入量产和头部封装厂 DEMO 和销售，研发人员不仅要花费大量时间对内部的工艺、质量、生产人员进行培训、指导，对外部的客户产品试切和验证提供大量的技术支持，同时还要兼顾新产品研发、试制和验证工作，所以人力资源的配置上更需要做好统筹规划，充分利用公司共用技术平台，提高国内团队与英国、以色列研发系统整体的协同效应和工作效率，保障项目的顺利进行。

3) 生产系统工作

2021 年生产系统面临的最大挑战是要保证全自动双轴晶圆切割划片机 8230 产能满足市场需求。同时，还要应对客户要求交货期短的挑战，生产系统各环节都需提前做好规划、预案和应对措施。

生产系统管理层和各业务模块核心骨干是一支在一线打硬仗的优秀团队，在他们的带领下，生产制造各车间已经培养出了诸多的优秀技术人员，过去经历过安全生产监控装备生产制造过程中各种困难、锤炼和考验，有信心也有能力完成好各项新的生产任务。

4) 人力资源工作

作为一家以中国为根基的国际化公司，随着公司业务领域从以传感技术为核心的智能化安全生产装备转向以高性能、高精度空气主轴为核心零部件的半导体划片机装备，新业务对研发、生产、销售和服务人员的素质和技能要求发生了巨大变化。光力的人力资源规划和管理必须要随之而变化，重点解决以下问题：现有及未来新员工的素质和能力要求，如不同岗位对英语的说、写、阅读能力的任职要求；跨国团队协作面临的文化差异、工作习惯差异；不同国家和地区员工之间的融合和配合度等等问题。

公司的人力资源规划将进行重大变革以适应公司现在和未来的战略布局和发展。

2021 年，公司推出了包含半导体高端人才在内的限制性股票激励计划。同时，在全公司范围内，结合公司业绩指标和个人业绩指标，科学设计并推出合理的奖金分配激励方案。

面向未来，我们有足够的自信去留住人才、吸引更多国内外志同道合的有志之士加入光力大家庭，我们相信一家拥有梦想、拥有世界级高精尖技术并且已经成功进入半导体高端装备领域的国际化光力，能为有理想有追求的人才提供广阔的发展平台和良好的发展机遇，通过科学设计的激励计划，按人才的贡献价值合理分配利益。

我们将持续加强人才建设，打造一支稳定、有战斗力、高素质的人才队伍，为公司的可持续健康发展提供人才保障。

5) 信息化建设

2021 年全力打造匹配公司当下和未来发展战略的统一的集团管控信息管理平台。全面实施集团化管控的 ERP 系统，实现从业务流转向数据流的管理模式。2021 年计划全面实施基本管理软件功能，按照国内总部——国内子公司——国外子公司的顺序上线实施。

航空港新厂区总体规划和建设方案为深度融合信息化的智能化工厂，逐步实现业务流、信息流和数据流的协同效应。

6) 证券事务工作

2021 年，证券事务部两项重要工作：一是向特定对象发行股票项目；二是收购先进微电子（ADT 母公司）股权。

向特定对象发行股票项目：为大力发展半导体装备业务，公司启动了向特定对象发行 A 股股票事项，并于 2021 年 1 月收到证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次计划募集资金 5.5 亿元，其中 4 亿元用于半导体智能制造产业基地项目一期建设。预计主体完工时间 2021 年 10 月。该项目达产后，将形成年产 300 套半导体精密划片设备及系统的产能。

收购 ADT 股权：公司目前已基本完成收购高瞻资本持有的先进微电子 10.71% 的股权，光力科技实际持有先进微电子 26.02% 股权（对应持有以色列 ADT 的 26.02%

股权），成为 ADT 第二大股东。2021 年将继续收购先进微电子其他股权，加快公司国际化战略的实施，更好地整合资源，加快公司在半导体领域新产品研发和国产化步伐，进一步奠定公司在半导体封测装备业务领域坚实的战略基础。

2020 年，因为疫情和复杂多变的国际形势，我们经历百年难遇之大变局，也迎来世界发展新局面。公司布局半导体封测装备领域多年，拥有半导体先进精密切割技术和核心零部件，已经有 8230 半导体切割划片机产品进入批量化生产。作为一家以中国为根基的国际化高科技企业，我们将珍惜时代赋予的使命，抓住机遇，快速行动，早日实现头部封装厂半导体装备国产化替代。

公司现在和未来，依托高性能、高精密空气主轴为核心零部件，对标行业领军企业，力争实现更大的发展。

2021 年，企业新的年号是“创新突破，融合筑梦”——务实、求精、共赢。务实又创新的光力人坚持“无业可守、创新图强”的经营理念，持续以技术创新为核心，以市场开拓为导向，在董事会的整体部署和正确领导下，公司上下齐心协力加快落实战略举措，脚踏实地，砥砺前行，排除万难，努力实现公司既定的年度经营目标。

光力科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日